

## **锦州神工半导体股份有限公司**

### **关于 2022 年年度利润分配方案的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。主要原因为综合考虑目前公司所处行业特点及公司发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展。

#### **一、利润分配方案内容**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 158,141,626.89 元，公司期末可供分配利润为人民币 419,549,108.75 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.12%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 158,141,626.89 元，公司累计未分配利润为 419,549,108.75 元，公司拟分配的现金红利总额为 16,000,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

公司本年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

经过半个多世纪的发展，“全球分工，自由贸易，效率优先”的国际半导体产业链已经发展成熟，分工严密且不断加深；但另一方面，近年国际政治经济局势的变化，也正在推动全世界主要经济体走向“芯片制造本土化”，各国竞相推出巨额补贴和政策支持，上马本土集成电路制造产能，全球集成电路制造产能的扩产规模和增速相比往年有所增加。根据国际半导体设备和材料协会（SEMI）于 2022 年 12 月公布的数据，2021 年至 2023 年，全球半导体产业将投资超过 5,000 亿美元，新增 84 处集成电路制造工厂。其中，2022 年全年共有创纪录的 33 处工厂开工，2023 年还将有 28 处工厂开工。集成电路制造厂作为产业链核心企业，短期内大规模增加的资本开支，将对上游设备和材料厂商造成扩产和交付压力。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

在大直径硅材料领域，凭借多年的技术积累及市场开拓，公司在产品成本、良品率、参数一致性和产能规模等方面均具备较为明显的竞争优势，细分市场占有率不断上升，市场地位和市场影响力不断增强。目前公司已扎根于分工严密的国际半导体供应链中，大直径硅材料直接销售给日本、韩国等国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备厂商，例如美国泛林集团（Lam Research）和日本东电电子（Tokyo Electron Limited, TEL），并最终销售给

三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商。

### （三）公司盈利水平及资金需求

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来资金需求，公司提出 2022 年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

公司目前处于快速发展的重要阶段，需要大量资金的支持。本次方案是兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点，经营战略需求以及公司的资金需求安排，本着回报股东、促进公司稳健发展的因素而提出。

### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司未来将持续聚焦主业，公司留存的未分配利润主要用于研发投入、拓展新业务等发展需求，以此提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展。

公司将一如既往地重视以现金分红的形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，积极执行公司利润分配的相关制度，与广大股东共享公司成长和发展的成果。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司行业特点、公司经营模式、盈利水平、资金需求、发展阶段、以及未来可能面临的风险等方面，兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于为投资者获取更大价值，保障公司稳健发展，不存在损害中小股东利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。我们同意公司 2022 年度利润分配预案。

### （三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

公司 2022 年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析行业环境和发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。因此，我们同意本次利润分配方案。

### 三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 3 月 18 日